



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 34502—2017

---

## 封装键合用镀金银及银合金丝

Gold-coated silver and silver alloy bonding wires for  
semiconductor package

2017-09-29 发布

2018-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)负责归口。

本标准起草单位:北京达博有色金属焊料有限责任公司、山东科大鼎新电子科技有限公司、有色金属技术经济研究院、浙江佳博科技股份有限公司、广东佳博电子科技有限公司。

本标准主要起草人:闫茹、向翠华、向磊、李天祥、赵义东、周钢、周晓光、刘洁、高亮、梁忠、孙妮。

## 封装键合用镀金银及银合金丝

### 1 范围

本标准规定了半导体封装包括分立器件、集成电路、LED 封装用镀金银及银合金丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单(或合同)。

本标准适用于半导体封装键合用镀金银及银合金丝。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10573 有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T 11067(所有部分) 银化学分析方法

YS/T 938.4 齿科烤瓷修复用金基和钯基合金化学分析方法 第 4 部分:金、铂、钯、铜、锡、钢、镓、铍、铁、锰、锂量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

### 3 要求

#### 3.1 产品分类

产品按不同基体可分为镀金银丝和镀金银合金丝两大类,镀金银丝型号为 HSG,镀金银合金丝按基体银含量不同分为 AS3、AS6、AS8、AS13 型号。产品的种类、型号、状态、直径应符合表 1 的规定。

表 1

种类	型号	状态	直径/mm
镀金银丝	HSG	半硬态	0.013,0.015,0.016,0.017,0.018,0.019,0.020,0.021,0.022,0.023,0.024,0.025,0.028,0.030,0.032,0.033,0.035,0.038,0.040,0.042,0.043,0.044,0.045,0.050
镀金银合金丝	AS3	半硬态	0.018,0.020,0.023,0.025,0.030,0.038
	AS6	半硬态	
	AS8	半硬态	
	AS13	半硬态	
注:可根据需方要求生产其他直径的产品。			

#### 3.2 产品标记示例

##### 3.2.1 每轴镀金银丝标记

